

キヤノン株式会社
2023年経営方針説明会

インダストリアルグループ

2023年3月6日

専務執行役員 インダストリアルグループ管掌

武石 洋明

Canon

本資料で記述されている業績見通し並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

最先端のエレクトロニクス産業向けに 多彩な製造ソリューションを展開

光学機器事業本部



半導体露光装置



FPD露光装置



計測機器

キヤノントッキ



有機ELディスプレイ製造装置

キヤノンアネルバ



スパッタリング装置



ドライエッチング装置



原子拡散接合装置



マイクロフォーカス
X線源

キヤノンマシナリー



ダイボンダー



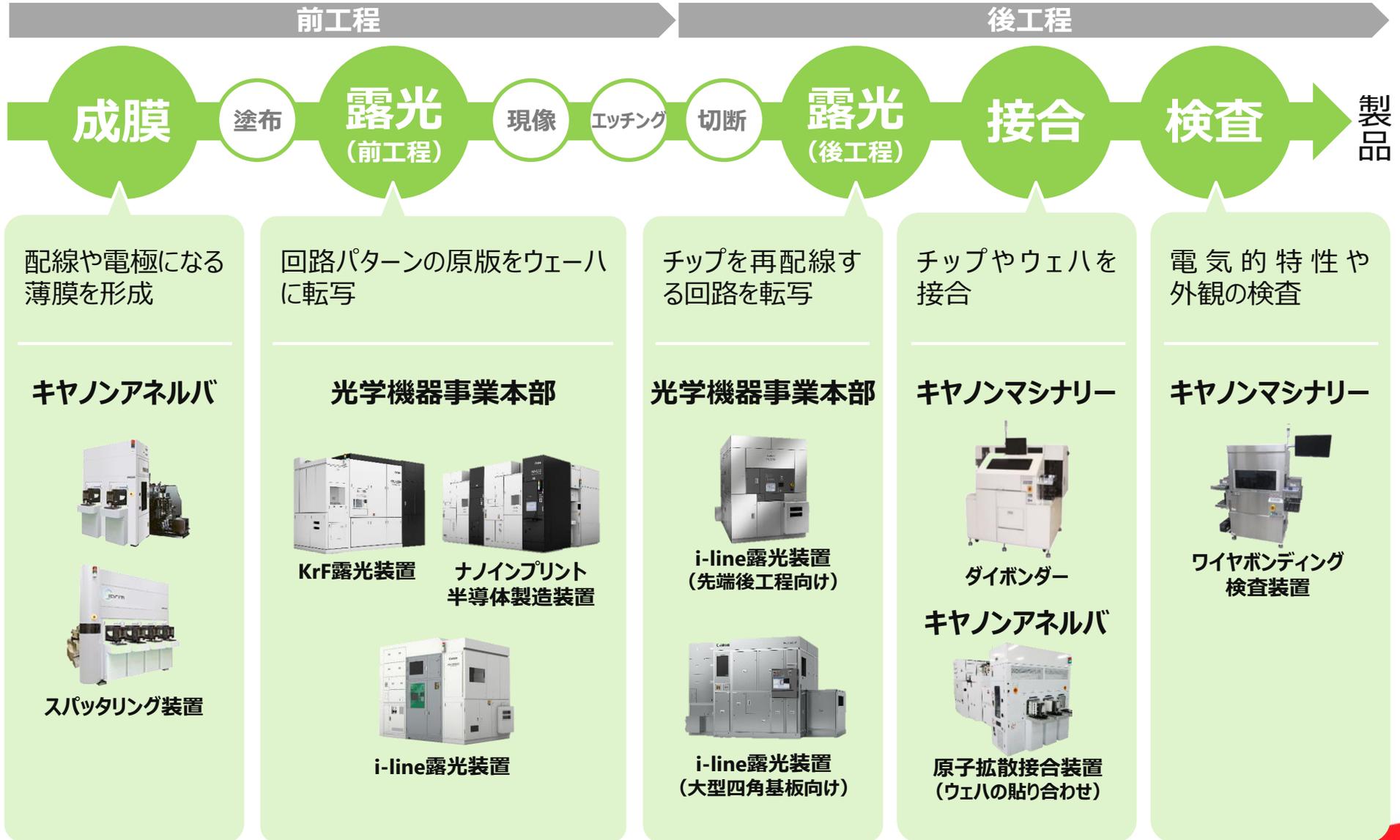
ワイヤボンディング
外観検査装置



基板コインング装置

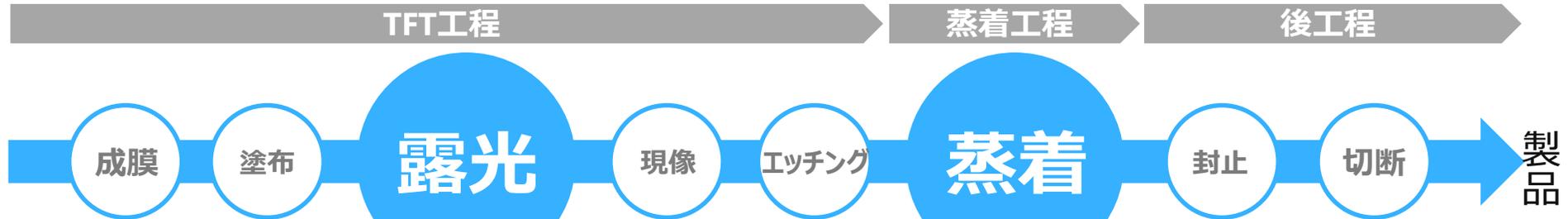
インダストリアルグループが展開する半導体製造装置

半導体デバイスの製造プロセス（抜粋）



インダストリアルグループが展開するディスプレイ製造装置

ディスプレイの製造プロセス（抜粋）



回路パターンが描画された原版をガラス基板上に描写

光学機器事業本部



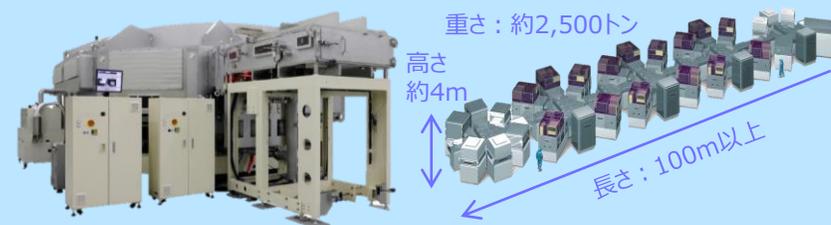
G6基板向けFPD露光装置



G8基板向けFPD露光装置

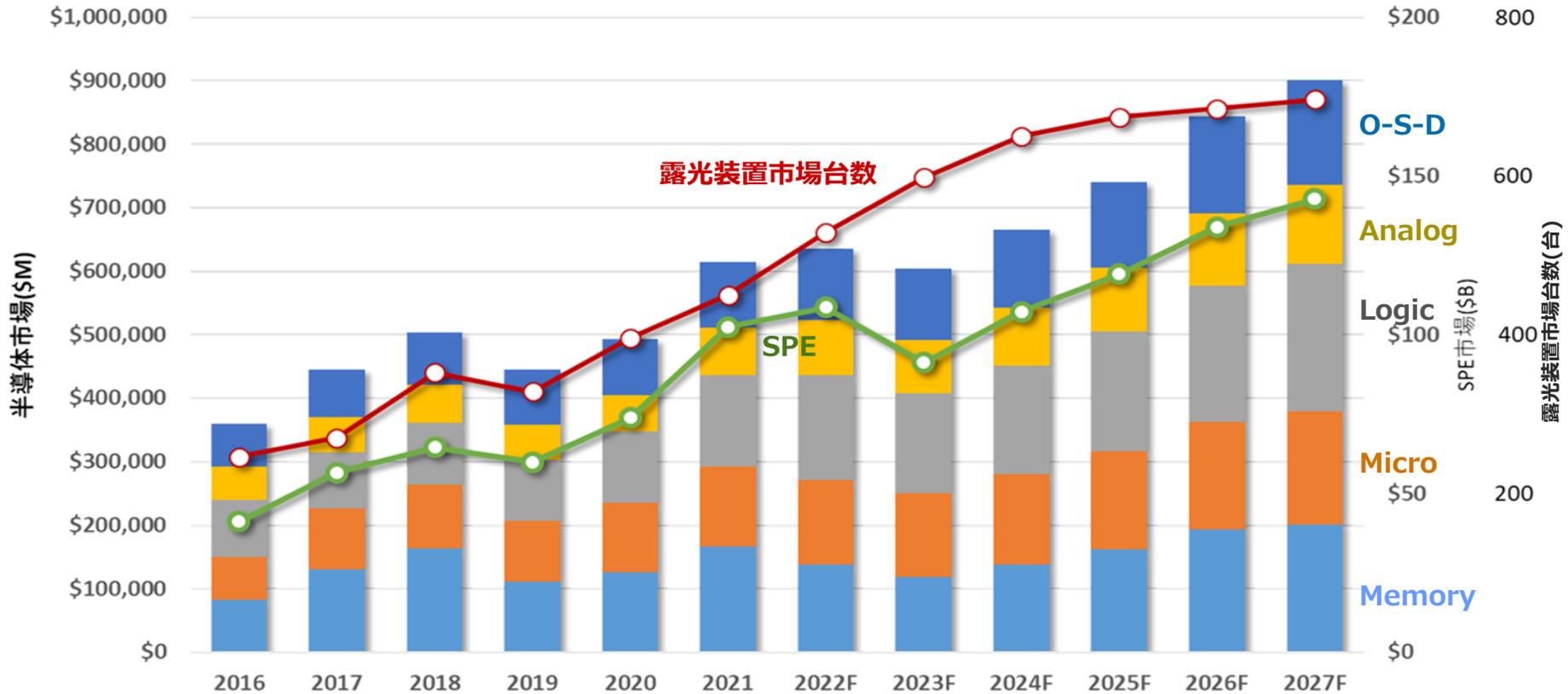
真空内で有機材料を加熱し、蒸発させ、ガラス基板上に薄膜を形成

キヤノントッキ



有機ELディスプレイ量産装置

半導体の市場動向



半導体市場、SPE市場、露光装置市場台数

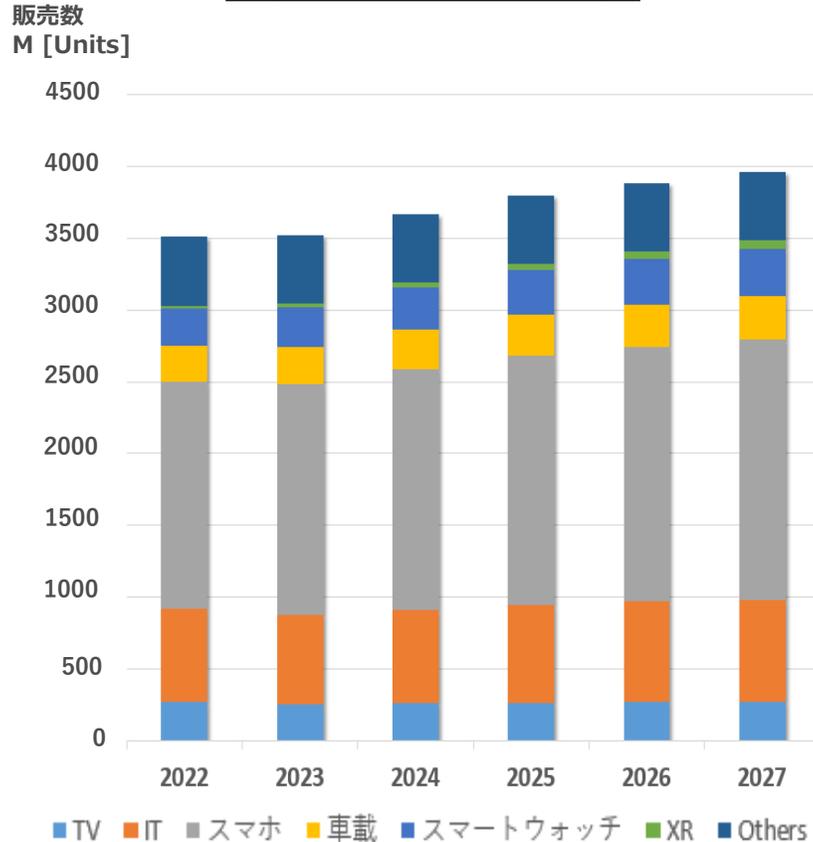
調査会社レポートをもとにキャノン予測

CAGR ₂₁₋₂₇	
O-S-D	7.2%
Analog	9.3%
Logic	9.7%
Micro	6.8%
Memory	3.7%

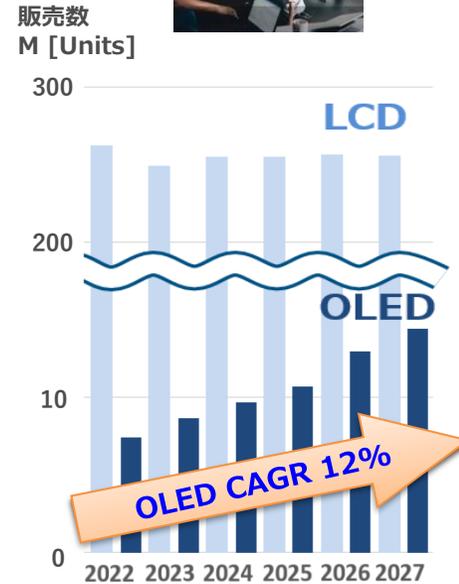
※O-S-D Optical Sensor Discrete Device

パワー、センサー、ロジックは堅調、メモリーも2023年下期から回復を見込む
足元での減速感はあるものの、活発な設備投資が継続

ディスプレイ (全体) 動向

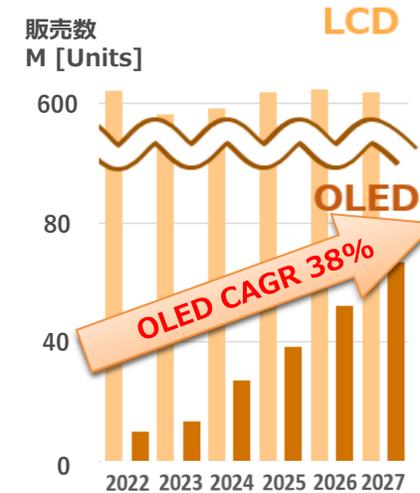


TV市場 (大型) 動向



IT※市場 (中型) 動向

※デスクトップ/ノートPC、タブレット



スマホ市場 (小型) 動向



調査会社レポートをもとにキヤノン予測

足元の市況軟化で、パネルメーカー各社が次の機会をうかがう展開
有機ELのアプリケーション拡大が、今後の市場成長を牽引する

- 半導体製造における規模、領域、アプリケーションの拡大
- 有機ELディスプレイ向け製造装置の競争力の向上
- データソリューションビジネスの強化・展開
- コア技術の融合による新規事業ドメインの開拓

半導体製造における規模、領域、アプリケーションの拡大（1）

SoC量産用製品ラインナップ



ナノインプリント半導体製造装置
FPA-1200NZ2C



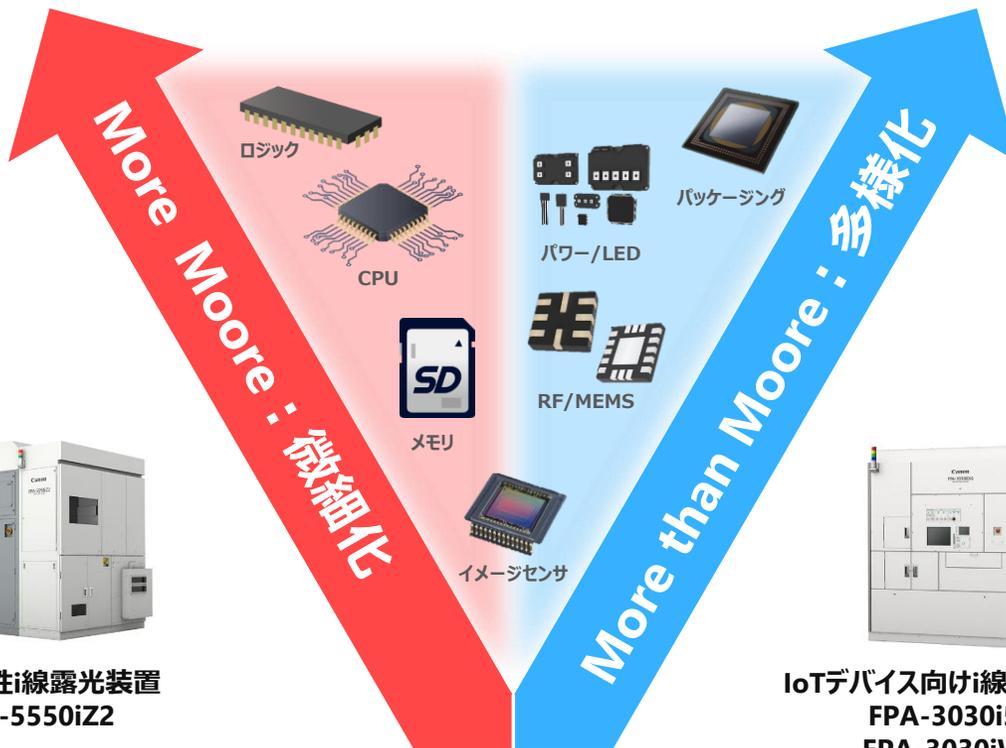
高生産性KrF露光装置
FPA-6300ES6a



ウェーハ計測機
MS-001



高生産性i線露光装置
FPA-5550iZ2



SiP 多品種生産用製品ラインナップ



WLP向け露光装置
FPA-5520iV



PLP向け露光装置
FPA-8000iW



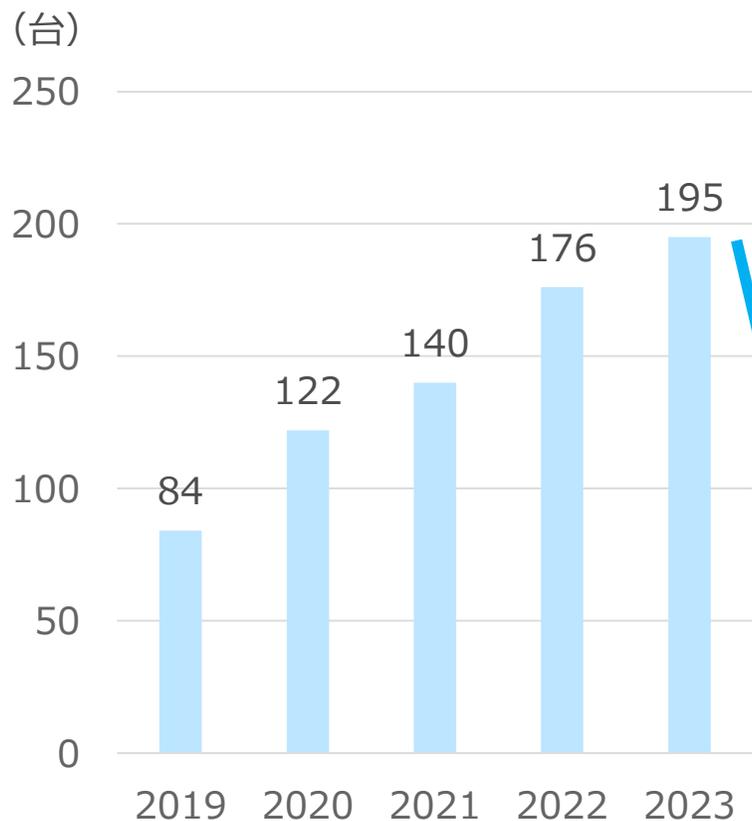
IoTデバイス向けi線露光装置
FPA-3030i5a
FPA-3030iWa



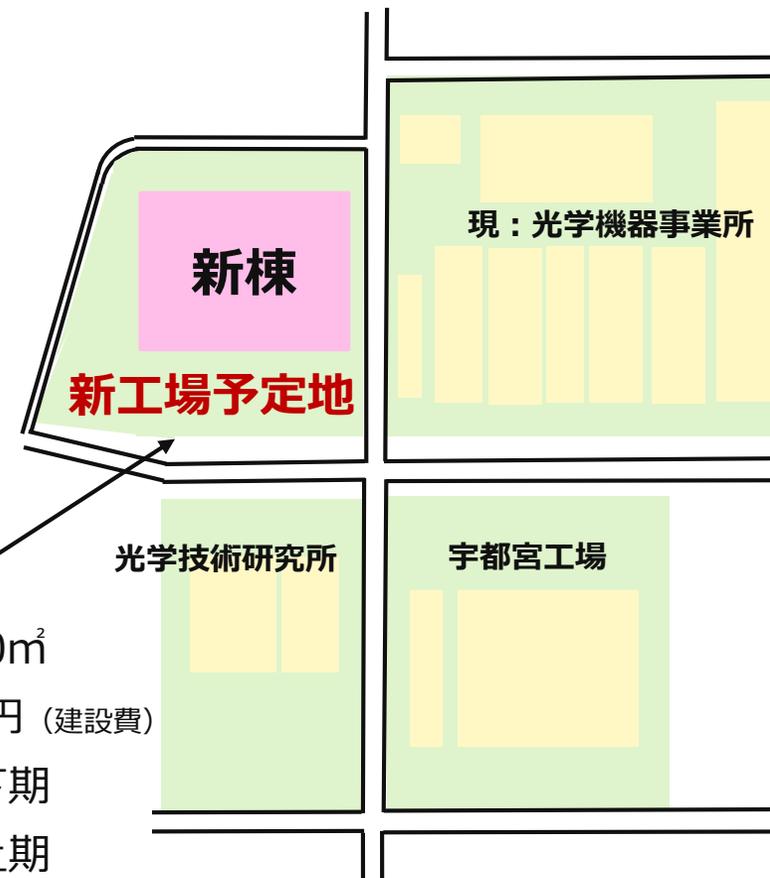
IoTデバイス向けKrF露光装置
FPA-3030EX6

半導体デバイスの微細化と多様化の二つの軸で、製品力を強化
中長期的に拡大する半導体市場の様々なニーズに応える

半導体露光装置販売台数



敷地面積：約70,000m²
投資額：約380億円（建設費）
着工予定：2023年下期
稼働予定：2025年上期



中長期的に見込まれる需要増加に応えるべく、宇都宮地区に新棟を建設
生産能力を強化し、半導体市場の成長を支える

有機ELディスプレイ向け製造装置の競争力の向上

解像度

高精細化



FPD露光装置
MPAsp-E903T



有機ELディスプレイ蒸着装置
System-ELVESS



FPD露光装置
MPAsp-E813T



FPD露光装置
MPAsp-H803T



FPD露光装置
MPAsp-H1003T



FPD露光装置
MPAsp-H1003H



大型化

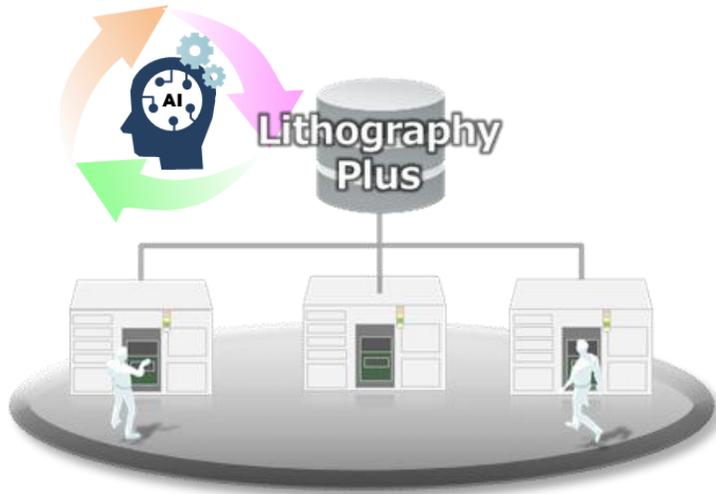
画面サイズ

市場での高い実績をベースに、顧客生産性をさらに向上
有機ELディスプレイの用途拡大を実現する（ITパネル、VR/XRなど）

データソリューションビジネスの強化・展開

半導体露光装置向けソリューションプラットフォーム“Lithography Plus”発売
 サポートのノウハウとデータを統合し、顧客ファブで稼働する露光装置の生産性を向上

- ①装置のサポート業務効率化
- ②高稼働率装置の実現
- ③各製造工程の条件を最適化し高い歩留まりの実現



価値の創出と顧客への提供、このサイクルを素早く回しながら、
 半導体製造現場のさらなる進化に貢献する

コア技術の融合による新規事業ドメインの開拓（1）

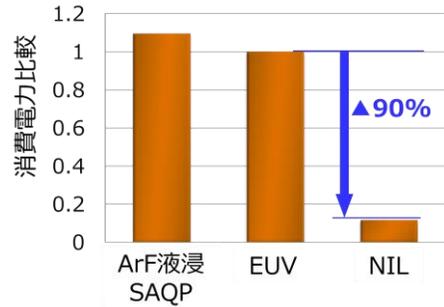
■ ナノインプリント半導体製造装置

■ 10nm台の回路パターンを低コストで実現する次世代半導体製造装置

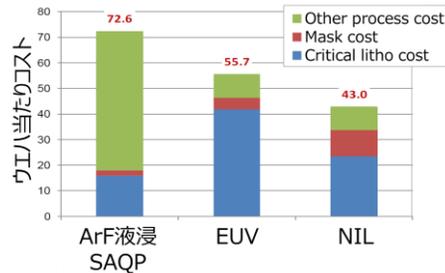


量産向けナノインプリント半導体製造装置
FPA-1200NZ2C

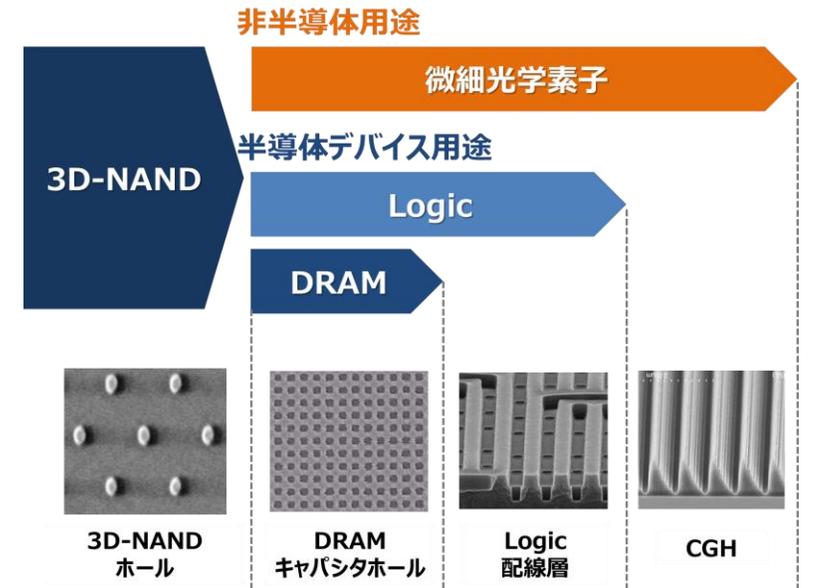
消費電力比較
(15nmパターン形成時、キヤノン見積もり)



製造コスト (CoO) 比較
(15nmパターン形成時、キヤノン見積もり)



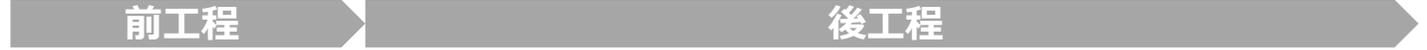
アプリケーションの拡大



3D NANDの量産プロセスへの適用準備と並行して、
DRAMやロジック、微細光学素子などへとアプリケーションを拡げていく

コア技術の融合による新規事業ドメインの開拓 (2)

半導体デバイスの製造プロセス (抜粋)



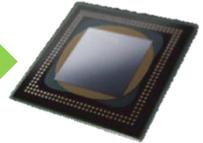
光学機器事業本部
先端パッケージ向け
i線ステッパー
FPA-5520iV



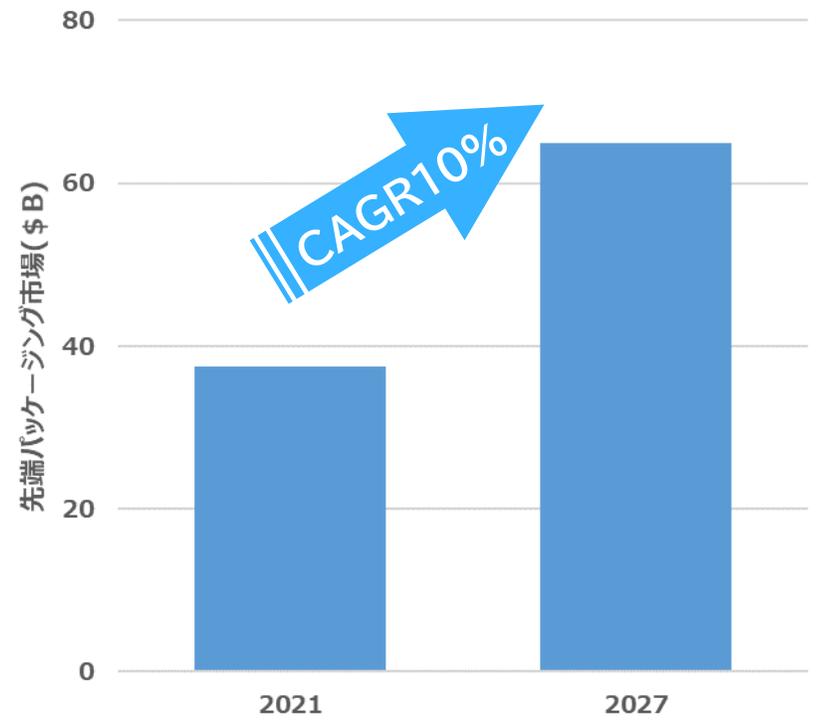
光学機器事業本部
大型四角基板向け
i線ステッパー
FPA-8000iW



アネルバ
原子拡散接合装置
BC7300



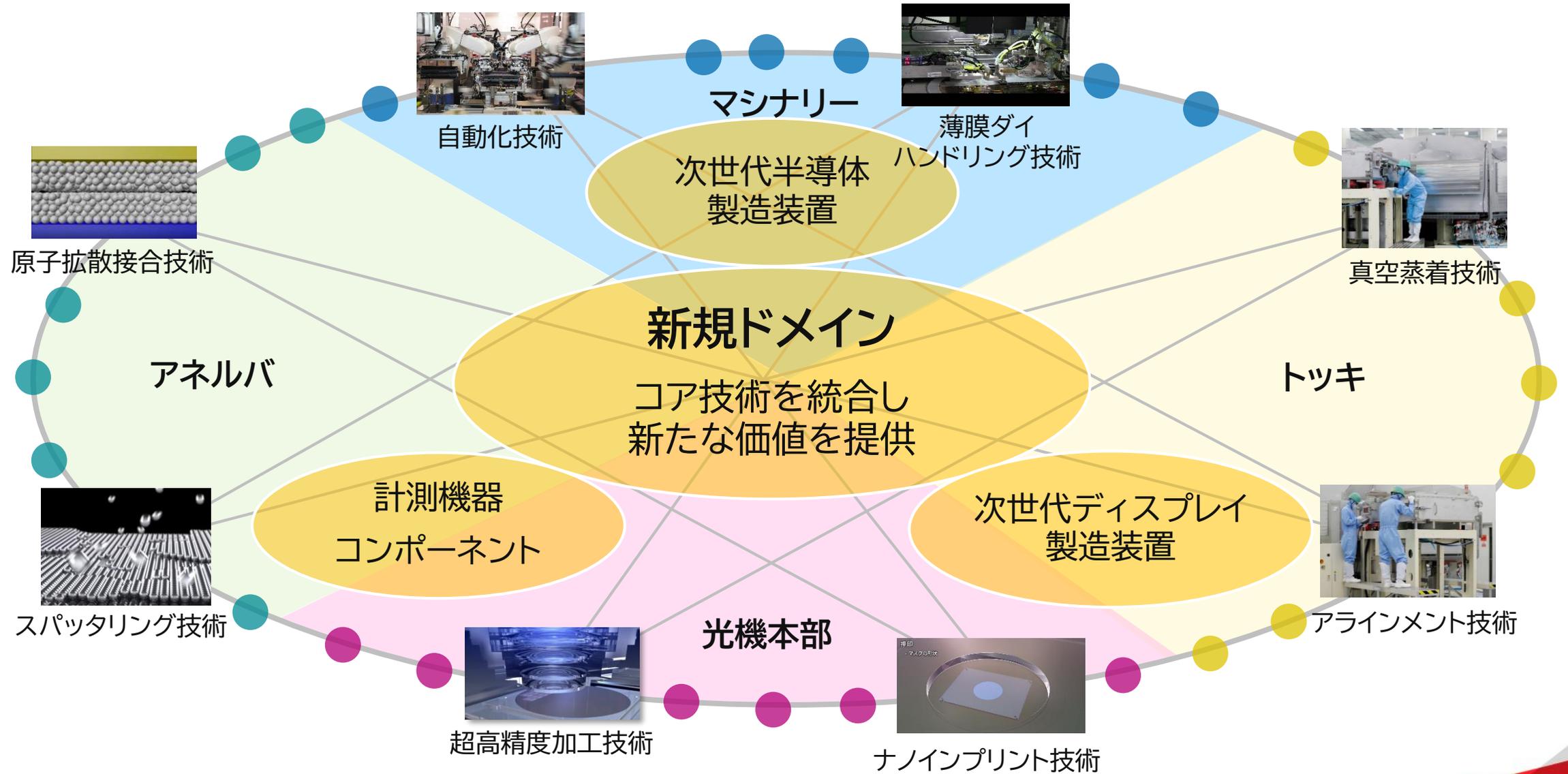
先端パッケージング市場

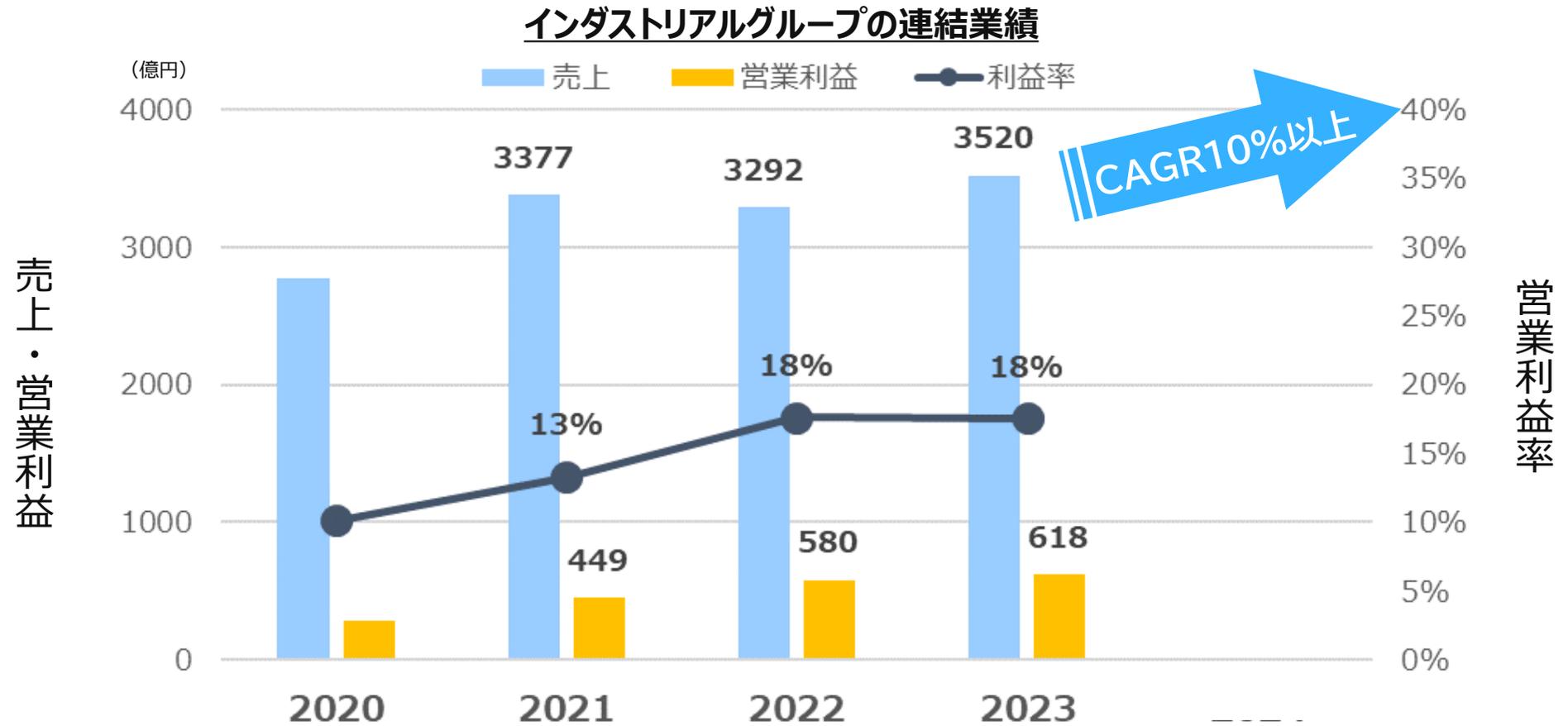


調査会社レポートをもとにキヤノン予測

先端パッケージングで複数の製品を展開中、
急拡大する市場の要求に応える次世代技術を開発していく

コア技術の融合による新規事業ドメインの開拓 (3)





サプライチェーンと生産体制の強化で半導体・ディスプレイ市場の需要を確実に捉え、
2025年までCAGR10%以上の成長を目指す